

证券代码: 002815

证券简称: 崇达技术

编号: 2025-007

崇达技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年半年度业绩说明会的投资者
时间	2025年08月28日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 姜雪飞 董事、副总经理、董事会秘书 余忠 财务总监 赵金秋 独立董事 黄治国
投资者关系活动主要内容介绍	1. 姜董，您好！贵公司半年报增收不增利，是否可以理解为PCB行业景气处于上升阶段，但公司成本控制相较同行来说还不够理想。是否未来考虑合并收购上游覆铜板生产能力，垂直一体化生产？或者是否有其他能够提升公司原材料议价能力的措施？谢谢！ 答：公司目前暂不考虑对上游覆铜板等环节进行并购以实施垂直一体化，公司将继续专注于PCB主业，通过技术创新和精益管理，巩固和提升在核心制造领域的竞争优势。自2025年5月起，我们加快推进产品价格策略调整，积极与客户协商，以更及时地反映成本变动。随着这些措施的落地，原材料价格上涨的影响正被快速对冲，毛利率水平预计将逐步修复并趋于稳定。谢谢关注！ 2. 光模块市场巨大，请问公司800G光模块有没有放量？1.6 T光模块开发进度怎么样了？谢谢 答：公司目前有小批量交付应用于800G光模块的PCB产品，但尚未大批量量产；对于1.6T技术，公司已启动前瞻性的技术储备和研发工作。谢谢关注！ 3. 800G光模块有没有放量，1.6T研发进度如何？ 答：公司目前有小批量交付应用于800G光模块的PCB产品，但尚未大批量量产；对于1.6T技术，公司已启动前瞻性的技术储备和研发工作。谢谢关注！ 4. 半年度的所得税费用大幅增加，说是抵扣项减少，请问为啥抵扣项突

然减少？

答:公司2025年半年度所得税费用同比增加,主要原因系可税前抵扣的研发费用加计扣除额度暂时性减少。我们严格遵循国家税收法律法规及会计准则,并坚定执行各项税收政策要求。谢谢关注!

5. 公司毛利率显著低于胜宏等,说是上游原材料涨价,请问为啥同行在面对上游原材料涨价时,依然可以实现环比毛利率增加,而你们却降低呢?

答:2025年上半年毛利率的波动,主要是报告期内,贵金属(特别是金盐)原材料采购价格快速上涨(同比+36.57%),对成本构成直接压力。由于公司与客户的价格调整机制存在一定的滞后期,未能即时将全部成本上涨压力向下游传导,从而短期内侵蚀了毛利率。

目前,公司已采取有效措施应对:自2025年5月起,我们加快推进产品价格策略调整,积极与客户协商,以更及时地反映成本变动。随着这些措施的落地,毛利率水平预计将逐步修复并趋于稳定。谢谢关注!

6. 崇达技术未来业绩有哪些增长点?与同业公司相比,崇达技术有什么优势?

答:公司未来的核心增长点在于:高端产品放量、下游需求爆发与产能释放的三重驱动。受当前市场景气度提升的影响,公司现阶段国内外订单需求均较为旺盛。特别是在手机、服务器、通讯等细分领域,产能及交货周期均面临较大压力,预计2025年公司在上述下游应用领域的销售订单将实现高速增长。同时,面向这些领域的高多层板、HDI板及IC载板等高端产品价格持续回升,产品结构优化将直接助推盈利能力改善。珠海高端产能与泰国基地的布局,为承接上述需求提供了坚实基础。

与同业相比,公司的核心优势在于深度绑定的优质客户群与卓越的快速响应能力。我们凭借产品品质、成本控制及价格策略等综合竞争力,深度服务全球知名客户,并通过“小批量、多品种”模式锻炼出较强的柔性生产和市场应变能力。当前,公司正继续深化国内外大客户战略,全力获取高附加值订单,以高效填充新产能,确保未来公司可持续增长。谢谢关注!

7. 贵公司上市10年,股票价格一路走低,当前PCB行业景气度上升,很多PCB上市公司股票价格屡创新高。公司说要争做PCB行业领军企业,但二级市场长期股价价格始终在低位,长期投资者持续处于亏损状态。究竟是什么原因?公司市值管理落到实处了吗?

答:公司致力于通过提升业绩、加强投资者沟通等多种方式,努力使公司价值得到市场的合理认可。我们深知,长期以来支持并陪伴公司成长的投资者承受了股价波动的压力。为此,公司将采取以下措施:

(1)持续优化业务结构,提升盈利能力,为公司股价提供坚实的基本面支撑。

(2)加强与投资者的沟通交流,定期举办业绩说明会等活动,增进市场对公司的了解和信任。

(3)探索并实施更多有利于股东回报的措施,如适时考虑分红政策的优化,以及在符合法律法规和公司发展战略的前提下,以多种方式回馈投资者。公司将继续秉承创新、务实的精神,致力于成为全球PCB行业的领军企业,为所有投资者创造长期价值。谢谢关注!

8. PCB 行业受覆铜板等原材料价格波动影响较大,公司是通过长期协议锁定采购价格?谢谢领导

答:公司目前并未全面采用长期协议来锁定覆铜板等主要原材料的采购价格。这主要由于PCB行业大宗原材料(如铜箔、树脂、玻纤布等)价格与全

	球大宗商品市场联动紧密，价格波动频繁且幅度较大，签订长期固定价格协议会带来较高的市场风险。 面对原材料价格波动，公司采取了一套综合性的、动态的采购管理策略来应对成本压力并提升议价能力，具体包括： 1、多元化采购与分盘策略：我们主动引入和维持多家合格的供应商，通过分散采购量来减少对单一供应商的依赖，从而增强采购环节的议价能力和灵活性。 2、紧密的战略合作与沟通：我们与核心供应商保持着密切的沟通与协作，及时了解市场行情变化，共同应对供应链波动，努力保障原材料供应的稳定性。 3、精细化库存管理：公司会根据市场需求预测和原材料价格走势，动态调整关键原材料的库存水平，在保证生产连续性的同时，尽量避免在高价位积累过多库存。 4、内部降本增效：公司内部持续深入推进“工段成本管理标准化”、提升材料利用率（如通过加大拼板面积）、提升人均产值等一系列管理活动，从内部运营中挖掘成本潜力。 5、产品价格传导机制：当原材料价格出现持续性的显著上涨时，公司会积极与客户协商，根据市场情况适时调整产品销售价格，以合理传导部分成本压力。谢谢关注！ 9. 领导，请问各个生产基地当前产能利用率是多少？谢谢（按产品类型拆分） 答：公司目前整体产能利用率85%左右，产能稼动率处于良好水平。谢谢关注！ 10. 姜总您好，目前公司研发投入重点投向“高阶 HDI、IC 载板”等领域，请问 IC 载板当前的技术成熟度如何？有通过某芯片厂商验证了吗？ 答：控股子公司普诺威专注于BT载板产品的研发生产，在深耕MEMS类载板市场的基础上，依靠多年累积的客户资源和产品经验，完成传统封装基板向先进封装基板的转型，已建成 mSAP（改良型半加成法）工艺产线，并于 2023 年9月正式连线投产。该 mSAP产线聚焦于 RF 射频类封装基板、SiP 封装基板、PMIC封装基板、TPMS基板等高端应用领域。mSAP工艺已在量产线宽/线距 20/20 微米的产品，ETS埋线工艺的线宽/线距能力可达15/15微米，技术能力方面可满足先进封装基板的量产需求。目前搭配mSAP工艺制作的产品已在大批量出货，近年来陆续完成行业头部企业（因涉及商业保密及行业敏感内容，不便详细披露，敬请谅解）的合格供方认证，部分项目已进入大批量出货阶段。未来公司将持续优化 mSAP工艺、提升产线的产能，进一步拓展其在SiP、PMIC、RF以及 5G 通信等先进封装领域的应用，以行业领先的技术及细分市场的积累来驱动业务增长。谢谢关注！ 11. 各位领导好，请问公司面对竞争对手，在中小批量 PCB的细分领域的核心竞争优势？谢谢 答：与同业相比，公司的核心优势在于深度绑定的优质客户群与卓越的快速响应能力。我们凭借产品品质、成本控制及价格策略等综合竞争力，深度服务全球知名客户，并通过“小批量、多品种”模式锻炼出较强的柔性生产和市场应变能力。当前，公司正继续深化国内外大客户战略，全力获取高附加值订单，以高效填充新产能，确保未来公司可持续增长。谢谢关注！ 12. 请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？ 答：公司未来业绩的核心增长点在于：高端产品放量、下游需求爆发与产
--	---

	能释放的三重驱动。受当前市场景气度提升的影响，公司现阶段国内外订单需求均较为旺盛。特别是在手机、服务器、通讯等细分领域，产能及交货周期均面临较大压力，预计2025年公司在上述下游应用领域的销售订单将实现高速增长。同时，面向这些领域的高多层板、HDI板及IC载板等高端产品价格持续回升，产品结构优化将直接助推盈利能力改善。珠海高端产能与泰国基地的布局，为承接上述需求提供了坚实基础。谢谢关注！ 13. 面对供应链不确定性，公司在关键物料安全库存设定、替代供应商开发方面的具体举措？谢谢 答：面对供应链不确定性，公司通过双轨策略保障供应链安全： 1、实施动态库存管理。根据物料采购周期和市场供需状况，差异化设置安全库存水位，并对紧缺物料适当提高库存缓冲，同时持续监控市场价格波动，动态调整库存策略。 2、构建多元供应体系。持续开发认证替代供应商，确保关键材料至少两家合格供应商；推动物料标准化和品牌替代，减少单一依赖；与核心供应商建立战略合作，通过中长期协议稳定供应。谢谢关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年08月28日